

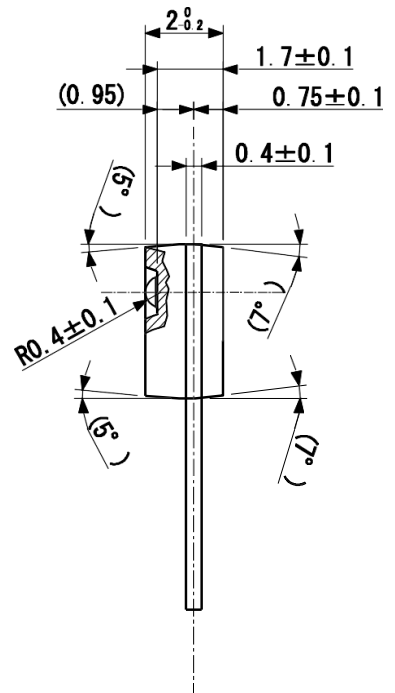
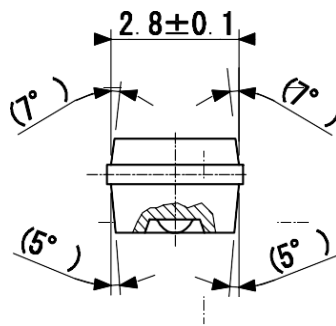
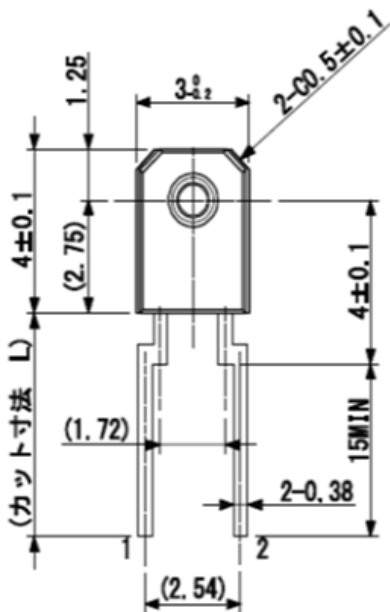
正面



側面



### 外形



ピン接続図



※ ( ) は参考値

### 特長

高品質かつ高耐久性でありながら、  
業界最薄クラスの薄さを実現しています

#### 1. パラジウムめっきフレーム使用で、高い耐久性を実現

一般的には製品完成後に半田めっきを行います。完成後めっきでは、めっき液が侵入し、品質事故につながる可能性があります。弊社製品は、プレめっきのため、その恐れがありません。

#### 2. 低温アッセンブリで、部材酸化による品質劣化なし

低温速硬化ダイボンドにより、チップ・フレーム・樹脂の高密着性を実現しています。またフレームの酸化防止・不純物の折出低減による高いボンディング品質により、部材酸化による品質劣化がありません。

#### 3. 高信頼の樹脂/構造の採用

高信頼性モールド樹脂、減圧でボイドレスのモールド、2重構造による劣化防止パッケージで、品質劣化を防止します。

#### 4. エピウエハーを採用し、大電流域でも安定動作

エピウエハーの採用により、 $V_{ce(sat)}$  が他社比較で40%程度低く、段電流域でも安定動作を実現しています。

# 薄型受光素子 DSLN250002

## 定格及び特性

絶対最大定格

Ta=25°C

項目	記号	定格値	単位
コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CEO</sub>	30	V
エミッタ・コレクタ間電圧	V <sub>ECO</sub>	5	V
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	50	mA
コレクタ損失	P <sub>C</sub>	75	mW
コレクタ損失低減率(Ta>25°C)	ΔP <sub>C</sub> /°C	-1	mW/°C
動作温度	T <sub>opr</sub>	-30 ~ +95	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +100	°C
はんだ付け温度(5s)	T <sub>sol</sub>	260 *1	°C

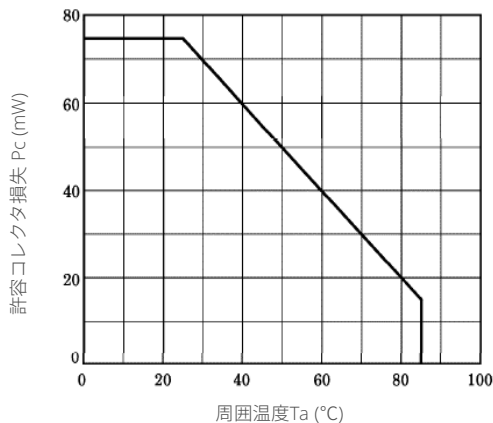
\*1: リード根元より2mm以上

## 電氣的及び光学的特性

Ta=25°C

項目	記号	条件	MIN	TYP	MAX	単位
暗電流	ICEO	V <sub>CE</sub> =24V, E=0	-	0.005	0.1	μA
光電流	IL	E=0.1mW/cm <sup>2</sup> V <sub>CE</sub> =3V	13	35	-	μA
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	E=0.1mW/cm <sup>2</sup> I <sub>L</sub> =15μA	-	0.15	0.4	V
ピーク感度波長	λ	-	-	870	-	nm
半値角	1/2θ	-	-	±8	-	°
応答時間	上昇時間	V <sub>CE</sub> =5V, I <sub>C</sub> =2mA, R <sub>L</sub> =100Ω	-	6	-	μs
	下降時間		-	6	-	μs

全許容損失低減曲線



分光感度特性

